

第 25 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 平成 24 年 5 月 11 日（金） 13：15～16：15
場所： 東京：東京事務所 4F 401、402、403 及び 404 会議室
筑波：総合開発推進棟 2F 中会議室 b2
（東京⇄筑波テレビ会議設定）

1. 開会の挨拶
2. JAXA からの報告 (13：15－13：45 30分)
 - 2.1 重要部品開発状況
 - 2.2 ESA 駐在報告
3. 部品ユーザからの情報 (13：45－14：00 15分)
（不具合、調達上の問題、今後期待する部品と技術など）
 - ・ NEC 東芝スペースサービス
4. 部品メーカーからの報告 (14：00－14：30 30分)
 - 4.1 電線・ケーブルの開発（日立電線）
 - 4.2 チップ形タンタル固体電解コンデンサの認定（松尾電機）
 - 4.3 n-ch パワーMOSFET（600V 品）の認定（富士電機）
- ◆ 休 憩 ◆ (14：30－14：45 15分)
5. 部品生産のスケジュールに関して (14：45－15：05 20分)
 - 5.1 POL
6. QPL/QML 部品認定状況 (15：05－15：35 30分)
 - 6.1 共通部品等の認定状況
 - 6.2 QTS/ADS の改定状況
 - 6.3 認定部品の変更管理状況
7. 海外情報 (15：35－16：05 30分)
 - 7.1 海外宇宙機関 関連情報
 - 7.2 G12/11 報告
 - 7.3 海外メーカーからの情報
8. その他 (16：05－16：15 10分)
 - ・ 半導体デバイスの放射線照射効果研究会
 - ・ 連絡会における要望について
 - ・ 今年度の行事予定
9. 閉会の挨拶